

# EPEA 中国电子专用设备工业协会

## 行业简讯

二〇二六年第三期

3月31日发

协会办公室编印

(总第460期)

(行业内交流)

### 内容提要

#### 协会动态

- ☆ 中国电子专用设备工业协会第十届二次理事会议在上海召开
- ☆ 中国电子专用设备工业协会二〇二五年度工作总结
- ☆ 中国电子专用设备工业协会二〇二六年工作要点
- ☆ 协会在北京召开2024年第二批团体标准评审会
- ☆ 4月30日前填报2025年电子专用设备主要经济指标统计报表

#### 行业动态

- ☆ 全球最大的半导体设备展(SEMICON CHINA 2026)在上海举办
- ☆ 国知局发布专项申请指引：标准必要专利申请有规可依

#### 会员动态

- ☆ 奥特维：新年连获重要订单，领跑大电芯模组PACK产线
- ☆ 盛美上海：获得全球多家客户先进封装设备订单
- ☆ 中科飞测：2025年营业收入预计同比增长48.75%
- ☆ 拓荆科技：2025年营业收入预计同比增长58.87%
- ☆ 京仪装备：2025年营业收入预计同比增长38.95%

- ☆ 华海清科：2025 年营业收入预计同比增长 36.46%
- ☆ 珂玛科技：2025 年营业收入预计同比增长 23.63% ~ 25.96%
- ☆ 屹唐股份：2025 年营业收入预计同比增长 9.57%
- ☆ 芯源微：2025 年营业收入预计同比增长 0.36% ~ 14.05%

## 市场动态与预测

- ☆ SEMI 报告：2025 年全球硅晶圆出货量增长 5.8%
- ☆ 2026 年 GaN 市场规模营收预计将达到 9.2 亿美元
- ☆ 2025 年全球动力电池装机量达到 1187GWh 同比增长 31.7%
- ☆ 2026 年中国大陆半导体设备在全球市场占比 28%

## 新会员

- ☆ 北科电子科技（苏州）有限公司
- ☆ 艾克欧东晟商贸（上海）有限公司
- ☆ 苏州华集数控科技有限公司

# 协会动态

## 中国电子专用设备工业协会第十届二次理事会议在上海召开



参加第十届二次理事会议的协会负责人  
左起：周惟仲、杨超、冯振坤、刘正德、陶珩、董博宇、王志越、朱亮、褚祥元、王坚、王飞

# 中国电子专用设备工业协会第十届二次理事会议决议

(2026年3月24日通过)

中国电子专用设备工业协会(以下简称“协会”)第十届二次理事会议于2026年3月24日在上海召开。应到理事单位70家,个人理事1名,实到理事单位65家,个人理事1名。

会议审议了以下文件与事项:

1、协会2025年度协会工作总结和2025年财务决算报告以及2025年度入会的新会员(共54家);

2、2026年度协会工作要点和2026年度财务预算方案;

3、协会分会负责人及副秘书长候选人推荐名单。

经与会代表的审议和讨论,本届理事会会议达成以下决议:

一、一致通过《协会2025年度协会工作总结》及《2025年度财务决算报告》,并确认和2025年新入会的54家会员名单及2025年度退会的29家会员单位名单;

二、对《2026年度的工作要点》予以认可,通过《2026年度协会财务预算方案》;

三、审议并表决通过以下协会分会负责人和协会副秘书长人事任命:

1、半导体设备分会负责人 陶珩;

2、新型显示与电真空器件设备分会负责人 陆峰;

3、电子元件与机电组件设备分会负责人 刘正德;

4、电子装联设备分会负责人 张帆;

5、净化与可靠性试验设备分会负责人 褚祥元;

6、核心部件分会负责人 刘冬梅;

7、新能源设备分会负责人 周惟仲;

8、审议并表决通过了协会副秘书长 李晋湘、叶乐志、金晓红。



中国电子专用设备工业协会第十届二次理事会议通过决议

# 中国电子专用设备工业协会

## 二〇二五年度工作总结

2025 年行业受到光伏产能过剩的影响，太阳能电池设备销售受阻，但在国内集成电路晶圆制造产业国内市场快速发展和出口交货增长推动下，中国电子专用设备行业主营产品销售收入得到缓慢增长。

### 2025 年上半年行业内 107 家规模以上电子专用设备制造商主要经济指标完成情况

	销售收入 (主营产品)	利润总额	税收总额	出口交货值 (主营产品)
金额(亿元)	622.13	101.51	26.22	64.38
同比增长(%)	1.4	-2.4	-32.0	87.6

预计，2025 年全年行业主营产品销售收入将增长 10%左右，达到 1400 亿元左右，除北方华创、晶盛机电已进入百亿元企业外，还有二家企业主营产品销售收入进入百亿元。

各位理事，一年来，在民政部和中共中央社会工作部的领导下、在工业和信息化部等政府有关部门的指导下，在全体会员单位的大力支持下，我们协会主要做了以下工作。

### 一、协助政府进行行业发展和管理的工作，积极参与、认真做好国家有关部门交办的工作，同时为会员单位申报重大技术装备优惠政策提供指导

1、按照工信部电子信息司的要求，提供了 2025 年电子信息制造业（电子专用设备部分）产业季度和年度发展形势研判材料。

2、按照工信部电子信息司的要求，提供了“十五五”电子专用设备产业发展的方向及路径报告。

3、按照工信部办公厅要求完成 2025 年版《中国信息产业年鉴》电子专用设备篇。

### 二、积极改进工作，努力为会员服务

1、在广大会员单位的主持下，完成了行业经济运行分析报告

(1) 5 月完成了行业内的 103 家规模以上电子专用设备制造企业的 2024 年主要经济指标的统计工作，并发布了《2024 年中国电子专用设备行业经济运行分析报告》。

(2) 6 月发布 82 家规模以上半导体设备制造企业《2024 年中国半导体设备行业经济运行分析报告》。

(3) 9月完成了行业内107家规模以上设备制造企业2025年上半年报主要经济指标的统计，发布了《2025年上半年的中国电子专用设备行业经济运行分析报告》和《2025年全年发展情况研判报告》。

## 2、成功举办了半导体设备年会、论坛。

(1) 9月4日~6日协会在无锡举办了《第十三届中国电子专用设备工业协会半导体设备年会》，本届年会举办了一场主论坛、16场专题论坛，近百位演讲嘉宾进行报告分享，近千位业内嘉宾听取了报告。

(2) 11月5日协会在上海举办了《第九届（2025年）半导体设备和核心部件新进展论坛》，北方华创微电子等十八家半导体设备制造商和核心部件制造商分别就本公司产品的新进展作了演讲，150多位代表参加了会议并进行了交流。

## 3、组织会员单位参加电子专用设备与部件展会

(1) 3月26日~28日，协会组织会员单位参与了《SEMICON China 2025》，协会160家半导体设备与部件会员单位参展，展位面积达到7022平米，其中协会专区47家会员单位参展，展位面积1530平米。

(2) 9月4~6日，协会组织会员单位参与了在无锡举办《第十三届半导体设备与部件展示会》，87家半导体装备与部件协会会员单位参展，展台面积3501平米。

(3) 11月5日~7日，协会组织会员单位参与了在上海举办的《2025年中国（上海）国际电子展》，12家会员单位参展，展位面积162平米。

## 4、编辑印发了三种刊物并在协会网站上刊登

(1) 《行业简讯》(月刊)，每月给会员单位(邮箱和会员群)发送(电子版)。

(2) 《2025年中国电子专用设备新产品汇集》(年刊)，免费为64家设备制造商会员刊登了150项电子专用设备新产品，印纸质件1600本，12月已发送会员单位和客户。

(3) 《2025年中国半导体设备核心部件选购手册》，免费为53家部件制造商会员刊登124项产品信息，印纸质件800本，2025年2月开始免费发送会员单位和客户。

5、依照会员单位的申请，2024年立项的六项团体标准通过起草、修改和审查，其中3项已经公示和发布，并在全国团体标准信息平台上公布报备实施，另外3项计划于2026年5月发布。2025年6项团体标准已列入计划。

### 2025 年协会已发布的三项团体标准

标准编号	标准名称	实施日期
T/CEPEA 0103-2024	半导体集成电路制造用原子沉积设备	2026.1.1
T/CEPEA 0102-2024	真空晶圆搬运机械手技术规范	2026.1.1
T/CEPEA 0101-2024	电子专用设备 13.56MHz 射频电源通用技术规范	2026.1.1

### 2025 年协会正在形成报批稿的二项团体标准

标准编号	标准名称	计划发布日期
T/CEPEA 0201-2024	集成电路装备用 13.56MHz 射频电源通用技术规范	2026 年 6 月
T/CEPEA 0203-2024	半导体设备前端模块通用技术条件	2026 年 6 月

### 2025 年列入计划的六项团体标准

标准名称	牵头起草单位	立项时间
集成电路装备用中低频射频电源通用技术规范	北京华丞电子有限公司	2025.12.17
真空铝合金钎焊工艺	北京北方华创真空技术有限公司	2025.12.17
真空焊接炉	北京中科同志科技股份有限公司	2025.12.17
大马士革铜电镀设备技术规范	盛美半导体设备(上海)股份有限公司	2025.7.30
半导体光伏制造用原子层沉积设备	江苏微导纳米科技股份有限公司	2025.7.30
12 英寸双轴全自动单面晶圆减薄机	江苏京创先进电子科技有限公司	2025.7.30

6、向国家知识产权局推荐了 26 届（2025 年）中国专利奖会员单位的三项发明专利（获奖项目待公布）。

7、主持了 1 项新产品（源卓微纳科技（苏州）股份有限公司研制的“TSM-10L 精密图形化曝光机”）科技成果鉴定。

### 三、加强协会自身建设工作

#### 1、加强党的领导

协会党建工作在中共中央社会工作部的领导下，协会办公室党员积极参加了工业和信息化部行业协会商会在京联合党支部组织的党课、组织生活会，增强了坚持党对协会全面领导的认识，为协会健康发展提供了有力保障。

## 2、召开了第九届五次理事会议

协会九届五次理事会于 2025 年 3 月 25 日在上海召开，理事会审议并一致同意《2024 年度协会工作总结与 2024 年度财务决算报告》，审议并一致同意《2025 年度协会工作计划和财务预算》。

理事会经过无记名投票推荐了第十届理事会候选负责人，并向中社部、工信部申报。

## 3、召开了第十届会员代表大会和十届一次理事会，完成了协会换届工作

12 月 10 日，在上海召开了中国电子专用设备工业协会第十届会员代表大会，选举了协会第十届理事会理事 71 名。在十届一次理事会上选举了十四位协会负责人，董博宇当选理事长，王志越当选秘书长（法人代表），并在国家民政部备案。

十届会员代表大会上修订了协会章程，已得到国家民政部的核准。

## 4、坚持依法办协会，严格遵守国家各项方针和法规

协会在业务活动中坚持依法办会。一年来协会坚决贯彻执行国家各项方针政策和法规。在这一年度中，协会各项证件的年检都顺利通过。

## 5、积极吸收新会员，并按照章程规定办理会员退会，增强了协会的实力

2025 年协会为 54 家行业内企业办理了入会手续。

2025 年协会按照协会章程规定的入会自愿、退会自由和一年不交纳会费的会员视为自动退会有关条例，有 29 家会员单位办理了退会。

到 2025 年底，协会有会员单位 364 家，同比增长 7.7%。

5、协会办公室返聘了 1 名行业内的退休员工，协会 2025 年底有专职工作人员 6 名，增强了协会服务的能力。

## 四、存在的主要问题和建议

1、行业国产高端电子专用设备市场占有率较低，需增强科技创新领军团队。

2、继续做好吸收新会员的工作，增强协会在行业内的代表性。

3、继续做好招聘行业内年轻工程师入职。

## 二〇二六年度工作要点

- 1、做好对接上级主管部门的工作。
- 2、3月24日召开第十届二次理事会议。
- 3、组织会员单位参加3月25日-27日 SEMICON China 展会。
- 4、8月31日-9月2日召开“第十四届中国电子专用设备工业协会半导体设备年会”。
- 5、开展行业（领域）调查研究工作，形成调查报告服务行业及会员单位
- 6、组织制定行业团体标准及相关知识产权管理推荐工作。
- 7、服务会员单位，组织新产品和科技成果鉴定会。
- 8、做好《行业简讯》（月刊）、《中国电子专用设备新产品汇集》（年刊）、《中国半导体设备核心部件选购手册》（年刊）采编等工作。
- 9、加强协会团队建设和做好协会日常工作。

### 协会在北京召开 2024 年第二批团体标准评审会

3月11日，中国电子专用设备工业协会在北京召开了2024年第二批团体标准送审稿评审会，由13位专家组成的标准审查组对《集成电路装备用13.56MHz射频电源通用技术规范》、《半导体清洗设备化学液混合排放通用规范》、《半导体设备前端模块通用技术条件》等三项团体标准送审稿进行了审查。

### 4月30日前填报 2025 年电子专用设备主要经济指标统计报表

统计和分析本行业的经济运行情况和经营动态，更好地推动今年的新品研制和生产经营工作，是行业的一项主要工作。

2025年行业主要经济指标报表可登陆协会官网 [www.cepea.com](http://www.cepea.com)，点击“报表下载”栏目下载。请各设备会员单位务必及时、正确填报（各单位填报的年报数据仅用于行业统计用不对外公布），并于4月30日前发送邮件到协会办公室年报接收邮箱（[cepea\\_vip@126.com](mailto:cepea_vip@126.com)）。

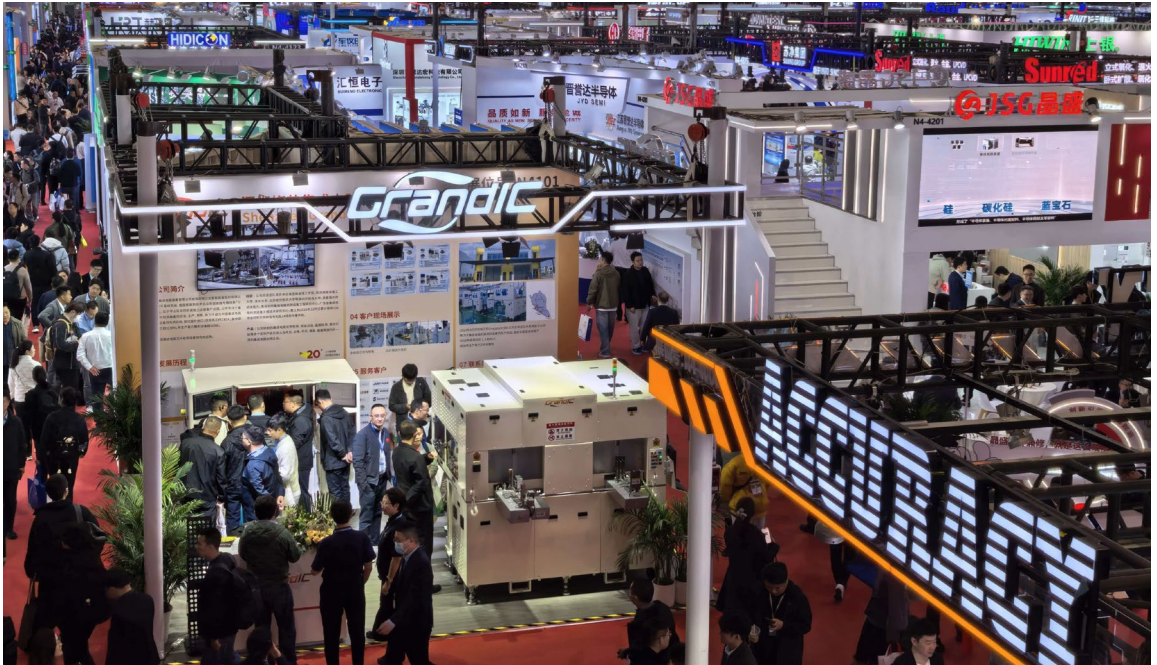
# 行业动态

## 全球最大的半导体设备展(SEMICON CHINA 2026)在上海举办

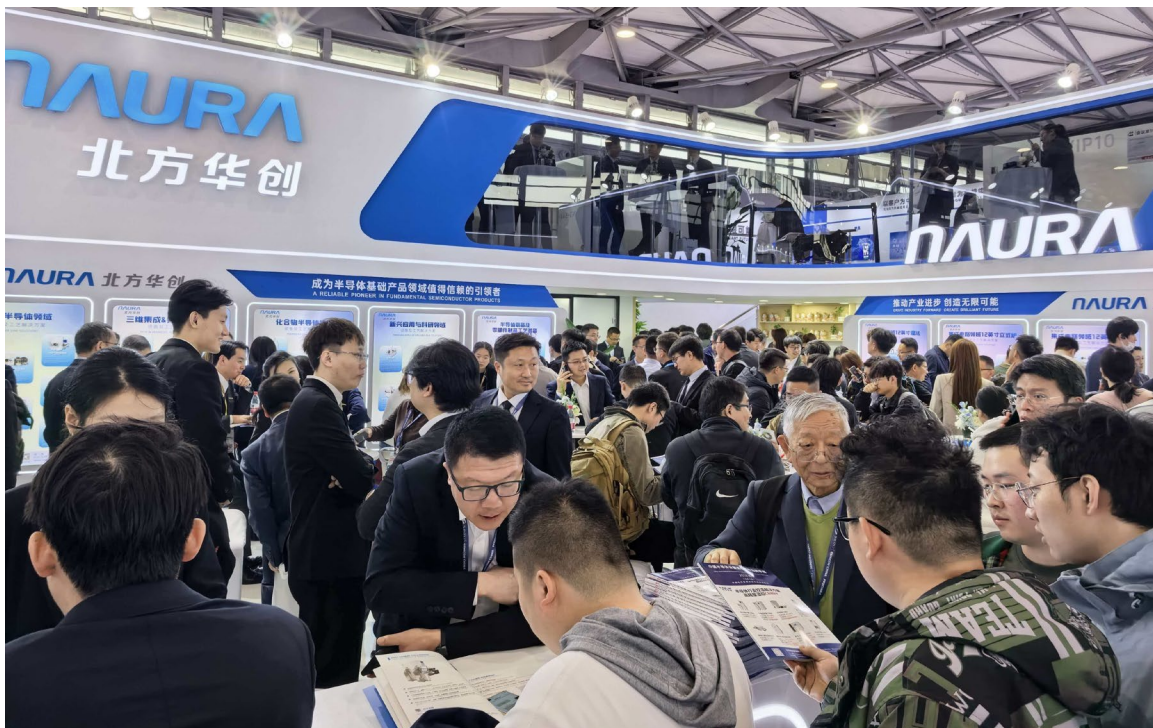
全球再大的半导体设备展《SEMICON China 2026》3月25日~27日在上海浦东新国际博览中心举办，展台总面积达10万平方米，1500多家展商参展。展会第一天观展人数达到7.9万人。

同期举办的20多场高端论坛则是智慧的熔炉。论坛覆盖创新投资、化合物半导体、AI智能应用和汽车芯片、智能制造、先进材料、异构集成（先进封装）、显示双引擎 OLED+Micro LED等产业热点，逾500位行业权威专家在此勾勒产业未来。

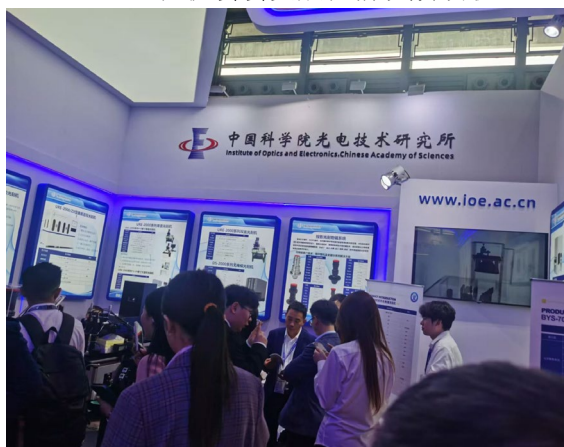
中国电子专用设备工业协会167家会员单位参展，展台面积7千多平方米。北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科、电科装备、长川科技等半导体设备头部企业都推出了已进入主流生产线的新产品。协会带来的700本《2025年中国电子专用设备新产品汇集》与300本《2026年中国半导体设备核心部件选购手册》在两天内便被一抢而空。



中国电子专用设备工业协会展区



在协会会员展位前观众领取《2025年中国电子专用设备新产品汇集》



## 国知局发布专项申请指引：标准必要专利申请有规可依

近期，本协会标委会在开展标准化工作中遇到会员单位在标准与专利协同、专利撰写规范上存在一些困惑。本文通过对国知局《涉及标准的发明专利申请指引》的解读，为会员单位提供参考。

### （一）标准化前期：筹备布局阶段（对应标准提案、起草期；专利构思、检索期）

核心是打好基础。在标准提案立项、起草初期，筛选可标准化核心技术，同步开展专利构思、专利检索与 FTO 分析，评估专利布局及侵权风险；对接标准化组织，明确标准起草、征求意见的周期与规则，同步启动专利申请的前期筹备。

### （二）标准化中期：协同推进阶段（对应标准征求意见、审议期；专利申请、审查期）

关键是实现专利与标准同步匹配。标准起草完成进入征求意见、审议阶段，技术方案逐步定型期间，同步完善专利申请文件，确保专利技术与标准核心内容贴合；通过制作权利要求对照表，逐一对比专利权利要求与标准技术特征，明确二者“对应”或“不对应”的结论；在标准审议过程中，按标准化组织要求披露专利信息，明确专利许可意向，同步推进专利实质审查，为标准落地扫清障碍。

### （三）标准化后期：落地维护阶段（对应标准批准、发布、修正期；专利授权、维护期）

重点是长效运营，标准经批准正式发布后，专利同步推进授权流程，完善 SEP 信息披露，按 RAND 原则开展专利许可，推动技术规模化应用；当标准进入修正阶段，同步评估修正内容对专利必要性的影响，调整专利组合、完善专利维护，适配标准更新；防范专利劫持、许可费堆积等风险，保障产业链安全，实现标准与专利全生命周期协同。

### （四）标准专利的撰写要点与申请策略

标准专利撰写需贴合标准、规避审查风险，重点把握 5 点：突出创造性、合理布局权利要求、规避修改超范围、采用标准通用术语、规范通信类专利撰写。

申请策略需适配标准 3-5 年的制定周期，可灵活运用优先权、新颖性宽限期、延迟审查三种制度。撰写与申请需遵循四大原则：贴合标准、防范风险、灵活调整、注重实用，兼顾审查要求与后续实务应用。

（来自：国家知识产权局 政策解读 涉及标准的发明专利申请指引）

## 会员动态

### 奥特维：新年连获重要订单，领跑大电芯模组 PACK 产线

新年伊始，无锡奥特维科技股份有限公司（简称：奥特维）智能锂电装备业务迎来“开门红”，连续斩获多个大电芯模组 PACK 产线、集装箱智能装配线及储能整厂级项目订单。

公司连续中标全球储能头部企业数条集装箱装配线与模组 PACK 线，并获得大圆柱模组 PACK 线订单。同时成功签约储能整厂级项目，涵盖电芯立库、智能物流系统及整厂 MES 等完整解决方案。凭借高兼容性、高可靠性、快速换型等技术优势，公司 587Ah 大电芯产线已形成可观在手订单，进一步巩固了在锂电高端装备市场的优势地位。

（来自：奥特维）

### 盛美上海：获得全球多家客户先进封装设备订单

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（简称：盛美上海）近日宣布，已获得来自全球多家头部客户的先进封装设备订单，标志着其产品平台化与客户全球化战略取得重要进展。

订单来自新加坡某 OSAT 企业的多台晶圆级电镀与湿法设备、来自中国大陆外某半导体封装厂商的面板级负压清洗设备、以及来自北美某科技企业的多台晶圆级湿法设备。

此次订单涵盖涂胶、刻蚀、清洗及电镀等多种设备，应用于晶圆级和面板级封装。其中，面板级负压清洗设备支持多种尺寸，能满足 AI 与 HPC 等应用对先进封装的严苛要求，彰显了公司差异化技术的全球竞争力。

（来自：盛美上海）

### 中科飞测：2025 年营业收入预计同比增长 48.75%

2 月 28 日，深圳中科飞测科技股份有限公司（简称：“中科飞测”或“公司”）发布 2025 年度业绩预报，公司营业总收入 20.53 亿元，同比增长 48.75%；扣非净利润-1.22 亿元。

营收增长得益于核心技术突破及产品迭代升级，新系列产品收入贡献增加，推动订单规模持续扩大。扭亏为盈主要系规模效应逐步凸显，研发投入稳步增长但占营收比例同比下降，盈利水平提升。

（来自：中科飞测）

## 拓荆科技：2025 年营业收入预计同比增长 58.87%

2 月 28 日，拓荆科技股份有限公司（简称：“拓荆科技”或“公司”）发布 2025 年度业绩预报，公司实现营业收入约 65.19 亿元，同比增长约 58.87%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约 7.26 亿元，同比增长约 103.79%。

业绩增长得益于在 AI、高性能计算等新兴领域驱动下，公司把握国产替代机遇，薄膜沉积及三维集成设备产品矩阵不断完善。依托 PECVD、ALD 等设备技术突破，先进制程核心竞争力显著提升，业务规模大幅增长。公司高强度研发驱动创新，基于新型设备平台的多款先进制程机台通过客户验证并实现产业化放量；ALD 设备收入大幅增长，产业化进程加速；混合键合设备收入保持高速增长。

（来自：拓荆科技）

## 京仪装备：2025 年营业收入预计同比增长 38.95%

2 月 28 日，北京京仪自动化装备技术股份（简称：“京仪装备”或“公司”）发布 2025 年度业绩预报。公司实现营业收入 142,624.29 万元，同比增长 38.95%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 11,423.62 万元，同比减少 1.31%。

业绩增长得益于公司积极把握半导体产业市场需求持续增长所带来的市场机遇，积极开拓市场，扩大销售，营业收入持续增长。

（来自：京仪装备）

## 华海清科：2025 年营业收入预计同比增长 36.46%

2 月 28 日，华海清科股份有限公司（简称：“华海清科”或“公司”）发布 2025 年度业绩预报，公司实现营业总收入 46.48 亿元，同比增长 36.46%；扣非净利润 9.67 亿元，同比增长 12.90%。

业绩增长得益于半导体市场需求强劲，公司持续加大研发投入，产品技术水平和性能持续提升。CMP 装备保持竞争优势，离子注入装备和磨划装备验证良好、出货快速增加，平台化发展战略进一步加强。公司成功开发多个新客户，市场认可度不断提高，为营收规模快速增长提供有力支撑。

（来自：华海清科）

## 珂玛科技：2025 年营业收入预计同比增长 23.63% ~ 25.96%

1 月 26 日，苏州珂玛材料科技股份有限公司（简称“珂玛科技”或“公司”）发布 2025 年业绩预告：2025 年年度营业收入 10.6 ~ 10.8 亿元，比上年同期增长：23.63% ~ 25.96%；扣除非经常性损益后的净利润盈利：2.85 ~ 3.34 亿元。

业绩增长得益于核心模块化产品大规模量产，陶瓷加热器产能释放，静电卡盘等小批量交付；半导体设备市场复苏及国产替代需求旺盛，推动销售增长。

（来自：珂玛科技）

## 屹唐股份：2025 年营业收入预计同比增长 9.57%

2 月 28 日，北京屹唐半导体科技股份有限公司（简称：“屹唐股份”或“公司”）发布 2025 年度业绩预报。公司实现营业收入 507,631.79 万元，同比增长 9.57%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 54,070.69 万元，同比增长 11.61%。

业绩增长得益于在人工智能等新兴产业推动下，集成电路设备市场需求持续增长。公司坚持国际化经营，推动干法去胶、快速热处理、刻蚀等设备市场开发，实现销售增长。通过加大研发投入，陆续开发并推出了新一代先进干法去胶设备 Optima®、新一代先进干法刻蚀设备 RENA-E®、先进等离子体表面处理和材料改性设备 Escala®等新产品，并获量产订单。北京研发制造基地产能提升保障销售增长。供应链多元化与本地化战略有效提高零部件国产化率，缩短物流周期并降低采购成本。

（来自：屹唐股份）

## 芯源微：2025 年营业收入预计同比增长 0.36% ~ 14.05%

1 月 27 日，沈阳芯源微电子设备股份有限公司（简称：“芯源微”或“公司”）发布业绩预告，2025 年营收预计 17.6 ~ 20 亿元，同比微增 0.36% ~ 14.05%；但归母净利润仅 5200 万 ~ 7600 万元，同比大幅下滑 62.53% ~ 74.36%，扣非后净亏损超 1600 万元。公司称，新签订单稳健增长，下半年与控股股东北方华创开启深度协同，但因薪酬费用增加、存货减值计提及政府补助减少等因素拖累盈利。

（来自：芯源微）

# 市场动态与预测

## SEMI 报告：2025 年全球硅晶圆出货量增长 5.8%

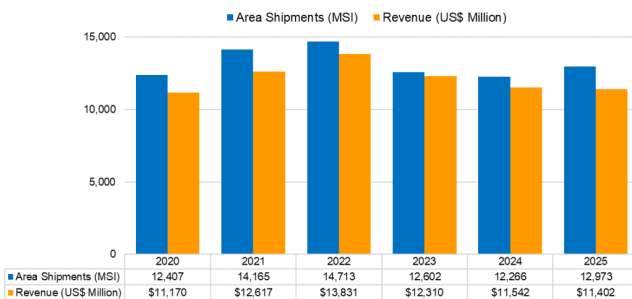
根据 SEMI 旗下的 Silicon Manufacturers Group (SMG)发布的硅片行业年终分析报告显示，2025 年全球硅晶圆出货量增长 5.8%，达到 12973 百万平方英寸（million square inch, MSI），而同期硅晶圆销售额下滑 1.2%，降至 114 亿美元。

2025 年是晶圆出货量的转折之年，受 AI 应用驱动，用于先进逻辑芯片的外延晶圆和用于高带宽存储（HBM）的抛光晶圆需求强劲，推动硅晶圆出货量恢复增长。晶圆销售额疲软主要归因于传统半导体应用增长乏力，其需求和价格环境尚未改善。

SEMI SMG 主席、胜高株式会社（SUMCO）销售与市场事业部执行副总经理矢田银次（Ginji Yada）表示：“2025-2026 年晶圆市场呈现出不同技术节点之间的分化趋势，在 AI 驱动的逻辑和 HBM 等先进应用领域，300mm 晶圆需求依然强劲，这得益于 3nm 以下工艺的持续采用。这些技术转型正在推动对晶圆质量和一致性要求的提升，进一步强化了先进材料解决方案的必要性。数据中心和生成式 AI 领域的投资持续支撑先进制程细分市场的需求，其中性能和可靠性至关重要。”

他进一步指出：“相比之下，传统半导体细分市场正逐步显现企稳迹象。成熟制程应用——如汽车、工业和消费电子领域的晶圆和芯片库存水平——在经历长期库存调整后已开始正常化。虽然供需状况正在逐季改善，但复苏步伐依然温和，需求恢复仍易受宏观经济因素和终端市场动态影响。因此，整体市场展望呈现双轨轨迹：先进制程需求持续旺盛且技术不断进步，而成熟技术细分市场的需求则呈现谨慎且渐进式的反弹。”

Worldwide Silicon Wafer Shipments (MSI) and Revenue  
Semiconductor Applications Only



Source: SEMI (www.semi.org), February 2026

Data cited in this release include polished silicon wafers, including those used as virgin test wafers, as well as epitaxial silicon wafers, and non-polished silicon wafers shipped by the wafer manufacturers to end users.

硅晶圆是多数半导体产品的基础材料，而半导体则是所有电子装置不可或缺的核心组件。这些高度工程化的薄型圆片，直径最大可达 300mm，是绝大多数半导体制造所使用的基板材料。

（来自：SEMI China）

## 2026 年 GaN 市场规模营收预计将达到 9.2 亿美元

**2026 年 GaN 市场规模营收预计将达到 9.2 亿美元，较 2025 年增长 58%。**

据全球领先的功率半导体和物联网公司英飞凌科技（Infineon Technologies）近期发布的一份报告显示，在氮化镓（GaN）功率解决方案日益普及的推动下，电力电子行业正经历着一场重大变革。这份 2026 年版年度《GaN Insights》报告深入剖析了 GaN 技术、其应用及未来前景。

“GaN 已成为市场现实，并在各个行业获得了广泛应用，” 英飞凌 GaN 系统业务线负责人 Johannes Schoiswohl 表示。

据分析师预测，到 2030 年，氮化镓（GaN）功率半导体市场规模预计将达到近 30 亿美元，较 2025 年增长 400%。这一快速增长主要得益于 2025 年开始的大规模产能爬坡，这将扩大 GaN 在多个行业的应用，并使其渗透到新的应用领域。事实上，预计 2025 年至 2030 年间，该市场将以 44% 的复合年增长率（CAGR）增长，2026 年营收预计将达到 9.2 亿美元，较 2025 年增长 58%。

氮化镓材料适用于高频、高温、高功率应用。作为一种宽禁带材料，和硅等传统半导体材料相比，具有更高的击穿场强、更快的电子迁移率和更高的饱和电子速率，具备导通损耗小、开关频率高、可双向导通等优势，能够在更高压、更高频、更高温度环境下运行。氮化镓制成的功率器件一般被称为 GaN HEMT（High Electron Mobility Transistor，高电子迁移率晶体）。

从衬底材料来看，硅衬底成本仅为碳化硅的 1/10，且可直接利用现有 8 英寸硅晶圆产线，硅基氮化镓（GaN-on-Si）因此成为最具成本优势的技术路线。

（来自：半导体产业纵横）

## 2025 年全球动力电池装机量达到 1187GWh 同比增长 31.7%

根据韩国市场研究机构 SNE 数据显示，2025 年全球动力电池装机总量 1187GWh，同比增长 31.7%。其中，宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能和蜂巢能源六家中国企业的总市场份额达 70.4%，比去年同期增加 3.3 个百分点。

（来自：集微网）

## 2026 年中国大陆半导体设备在全球市场占比 28%

《日经亚洲》最新发布的半导体设备产业展望报告指出，在人工智能（AI）芯片产能持续扩张与先进制程资本投入大幅升温的带动下，全球前五大半导体设备厂 2026 年营收可望重返双位数增长，写下 2022 年以来增长动能最佳表现。

报告进一步指出，2025 年至 2027 年间，全球晶圆厂设备支出总额预估将达 1560 亿美元，较 2022 年至 2024 年期间大幅增长 42%。

在投资结构方面，与 AI 相关的设备需求快速升温，包括高频宽存储（HBM）堆叠、先进封装（CoWoS）以及环绕式闸极（GAA）等技术，占整体设备支出的比重将由原本的 15% 大幅提升至 35%，跃升为设备厂最重要的增长来源。

### 美国成设备投资新重心

从区域布局观察，美国亚利桑那州、德州与纽约州新建晶圆厂设备投资增速达 45%，高于中国台湾（28%）与韩国（22%）。包括台积电亚利桑那 Fab 21 厂、三星德州泰勒厂以及英特尔 18A 制程厂都带动美系设备商本土订单激增。

值得注意的是，尽管美国持续收紧出口管制，中国大陆仍是全球第二大半导体设备市场。报告预估，2026 年中国大陆市场占比约 28%，低于 2024 年的 31%。

中国大陆成熟制程（28nm 及以上）投资也将维持高档，中芯国际等厂商持续扩产，DUV、蚀刻与薄膜设备需求稳健。不过，EUV 与部分先进制程设备对中国大陆销售几乎归零，对整体增长形成压力。

在进口设备受限背景下，中国大陆本土设备商迎来替代机会。

北方华创、中微公司与盛美上海 2025 年营收增速均超过 40%，蚀刻、薄膜与清洗设备已进入本土头部厂商产线。不过，中国大陆在微影与高阶量测设备领域仍存在技术落差，未来两年须突破 28nm DUV 量产与 14nm 套刻精度检测等关键门槛。

《日经亚洲》总结指出，全球半导体设备产业正进入“AI 驱动的超级周期”，双位数增长可望延续至 2027 年。

对仍积极扩产的中国大陆晶圆厂而言，设备供应趋紧代表“抢单”窗口缩窄；对中国大陆本土设备商而言，2026 至 2027 年将是技术验证与市占率提升的关键时期。

（来自：钜亨网）

# 新会员

## 北科电子科技（苏州）有限公司

会员证号：10011

法定代表人：FENG CAO 总经理：金荣

该公司是一家台港澳商独资企业，公司专注半导体专用设备部件的研制、生产和销售。主要产品半导体设备 OEM、半导体搬运装置控制系统和半导体用无尘拖链及视觉线缆组建等。该公司 2025 年完成销售额 1.6 亿元。公司现有职工 200 人，其中工程技术人员 40 人。

地址：江苏省苏州市工业园区桑田街 218 号生物医药产业园 3 栋 邮编：215123

电话：0512-6262 6355 手机：189 6216 0261

<http://www.nortechsys.com.cn> E-mail: [ddai@nortechsys.com](mailto:ddai@nortechsys.com)

## 艾克欧东晟商贸（上海）有限公司

会员证号：10012

法定代表人：TOGASHI TSUTOMU 总经理：三村诚

该公司是 IKO 集团（Innovation Know-how Originality）的全资子公司，外商独资企业。公司专注半导体等行业专用传动部件的研制、生产和销售。主要产品滚针轴承、高精度直线导轨及精密定位工作台等。

地址：上海市长宁区娄山关路 555 号长房国际广场 2301-2302、2310 室 邮编：200051

电话：021-3250 5525 <https://www.ikont.co.jp/cs/> E-mail: [ntc@ikonet.co.jp](mailto:ntc@ikonet.co.jp)

## 苏州华集数控科技有限公司

会员证号：10013

法定代表人：许耀满 总经理：邱粤兴

该公司是一家民营企业。公司在半导体材料加工方面（硬脆材料方面）有专门的特定机型研制、生产和销售。如：超声波三轴、四轴高速机，超声波五轴高速机，超声波钻孔攻牙机、精雕机等。2025 年销售额 1.2 亿元，公司现有职工 97 人，其中工程技术人员 15 人。

地址：江苏省苏州市相城区阳澄湖镇东横港街 388 号 邮编：215000

电话：189 1416 9678 <http://www.huajicnc.com/> E-mail: [huajust@163.com](mailto:huajust@163.com)

---

协会办公室地址：北京市复兴路 49 号 C 座 001  
电话：010-68860519  
<https://www.cepea.com>

邮编：100036  
传真：010-68865302  
E-mail: [bgs@cepea.com](mailto:bgs@cepea.com)